

エレクトロニクス

メタライゼーション

MID (Molded Interconnect Devices)

高い歩留まり、確かな選択性、LDS、Pd含有樹脂及びダブルショットMIDにめっき処理を容易にするため、最適化された新しいMIDめっきプロセスをマクダーミッド・エンソンがご紹介します。

マクダーミッド・エンソンの製品には銅、ニッケル、錫、銀、金めっき仕上げがございます。

それぞれがOEMのデザイナーやメーカーを念頭において設計されています。

これらは幅広い材料や触媒に対し安定した選択性を提供し最も需要の多い低コストな成形複合材料に対しより複雑で効率的な設計を可能にするプロセスです

シンプルで管理しやすいプロセスにより、安定しためっき速度と長く予測しやすい浴寿命が得られます。

今日、進化を続ける電子機器のなかでもウェアラブル機器などの難易度の高い最新デザインに対し、高い歩留まりと、高い信頼性を得られるマクダーミッド・エンソンMIDプロセスを是非ともお選び下さい。

※ 2014年11月7日(金) 東京大学で開催される「日本MID協会 定例会」において、日本マクダーミッドが「LDS プロセスにおけるファインピッチめっきへの取り組み」というテーマで講演を行いました。

定例会の詳細は



こちらをご覧ください。

Molded Interconnect Devices

Selective Metallization

The Stability You Want
The Yields You Need
The Technology
You Demand



Key Features

- LDS工法で成形されたパーツへの優れた選択的めっき析出性を実現
- 多くのプラスチック成形樹脂に対し高い歩留まりを実現
- 浴安定性が高く、寿命が長いシンプルなプロセスを実現
- ファインピッチめっきやワイヤボディング等、高スペックに対応した優れたプロセスを実現

MID Finishes

Copper, Nickel, Gold and Silver

Choose The Best
Finishes That
Stand Out From
The Rest



Key Features

- 高温に弱い成形樹脂向けに低温無電解ニッケルプロセス **NEW**
- 低、中、高リンの無電解ニッケルめっきプロセス
- コスト低減が可能な低金属濃度のMID Goldプロセス
- ニッケルや金を使用せず高周波特性に優れたMID Silverプロセス
- 多くのアプリケーションに対応し、様々な実装性を実現した最終表面処理プロセス

マクダーミッド社 [MIDの詳細資料](#) はこちら！

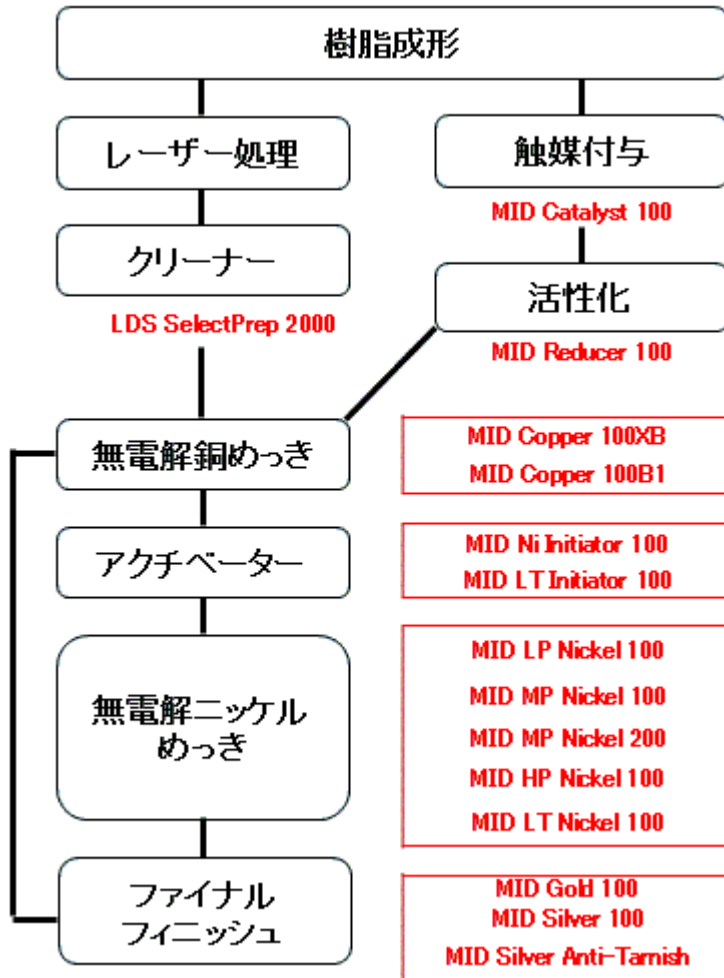




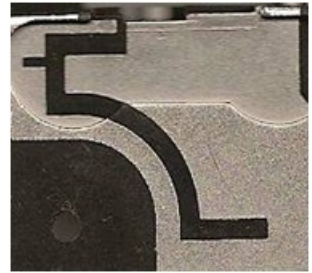
MIDめっきプロセス

●適用例

- ・ モバイル通信機器のアンテナとして
- ・ 自動車ハンドル部分のスイッチとして
- ・ 3D樹脂成形部品のメタライゼーション ●プロセスサイクル



MID Copper 100XB



MID MP Nickel 200



MID Gold 100

- ★ MID SelectPrep 2000 超音波併用型の弱アルカリクリーナー
- ★ MID Copper 100 XB ストライク&ビルドの2浴構成 無電解銅めっき
- ★ MID Copper 100 B1 ストライク&ビルドが1浴構成 無電解銅めっき
- ★ MID Ni Initiator 100 無電解Ni用Pdアクチベーター
- ★ MID Copper 100 B1 ストライク&ビルドが1浴構成 無電解銅めっき
- ★ MID LT Initiator 100 MID LT Ni 100用Pdアクチベーター
- ★ MID LP Nickel 100 低リンタイプの無電解ニッケルめっき
- ★ MID MP Nickel 100 中リンタイプの無電解ニッケルめっき
- ★ MID MP Nickel 200 中リンタイプの無電解ニッケルめっき
- ★ MID HP Nickel 100 高リンタイプの無電解ニッケルめっき
- ★ MID LT Nickel 100 低温浴対応の中リン無電解ニッケルめっき
- ★ MID Gold 100 MID用の置換金めっき
- ★ MID Silver 100 MID用の置換銀めっき
- ★ MID Silver Anti-Tarnish Anti-Tarnish MID Silver 100用の変色防止剤